

CUTTING EDGE

カッティングエッジ

80期事業のご報告

2018年4月1日～2019年3月31日



社長メッセージ



7年ぶりの減収減益となりましたが、中長期視点で「高度な Kiru・Kezuru・Migaku技術」の開発・投資を進めてまいります。

事業環境・業績

2018年度は、後半にかけて半導体メーカ各社の投資意欲が減退しましたが、年間を通じてはメモリメーカを中心に幅広い用途で設備投資が見られました。

こうしたなか、当社は前年との比較では大型案件が不在だったため7年ぶりの減収となりましたが、装置、消耗品の出荷はともに高い水準で推移し、売上高と利益は過去2番目の水準となりました。

株主還元につきましては、配当方針に基づき、業績連動型の配当に加え、余剰資金からの追加配当を上乗せして1株あたりの配当金は年間322円*とさせていただきます。

今後の見通し

足元では、スマートフォン向けの需要が減退していることに加えて、貿易摩擦により世界経済の減速に対する懸念が高まっています。しかし、中長期的には5G(第5世代移動通信システム)、自動車向け、データセンター向けなど様々な最終製品において半導体・電子部品需要が高まると予想され、それらの製造に必要な「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」の加工ニーズも着実に増加していくと見込まれます。

そのため、今後も積極的な研究開発の継続、桑畑工場や茅野工場の拡張・生産体制強化など、中長期視点で「対応力」の向上を図るとともに、引き続き良質な企業文化の醸成や

進化・改善活動など「会社を強くする」取り組みを進めてまいります。

ステークホルダーの皆様におかれましては、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※配当について
年間配当322円(内訳 中間114円、期末87円、余剰資金からの追加配当121円)
中間、期末の年2回、連結半期純利益の25%を配当、これに加えて、年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額を超過した場合は、業績連動分に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せいたします。

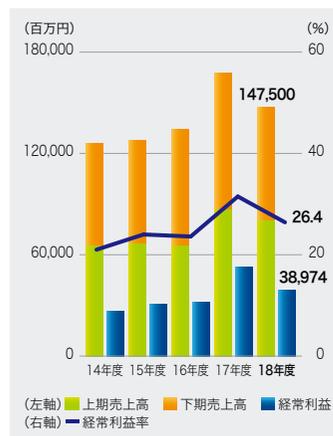
2019年6月

代表取締役社長 関家一馬

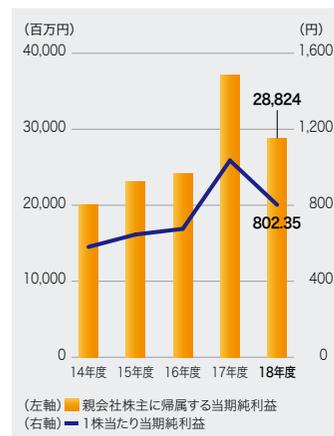


財務ハイライト

売上高・経常利益・経常利益率



親会社株主に帰属する当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)においては、上期にメモリ向けを中心に幅広い用途で設備投資が見られたものの、下期から半導体全般で設備投資意欲が減退しました。加えて、前期のような大型案件が無かったことも影響し、ブレードダイサ、グラインダ、レーザソーなど精密加工装置の売上は2割弱減少しました。また、消耗品である精密加工ツールは、高水準の出荷が続いていたものの、期末にかけて顧客の設備稼働率が低下したことが影響し、売上は前期と比べて減少しました。このような状況から、連結売上高は前期比減収となったものの、過去2番目の高い水準で着地しました。

利益については、製品構成の変化が影響しGP率の低下、研究開発活動による販売管理費の増加がありました。しかしながら、売上高の減少が主要因で減益となりました。しかしながら、利益水準は売上高と同様に過去2番目の高い水準となりました。

以上の結果、当期の業績は売上高 1,475億円(前期比 11.9%減)、営業利益 386億45百万円(前期比 24.2%減)、経常利益 389億74百万円(前期比 26.0%減)、親会社株主に帰属する当期純利益 288億24百万円(前期比 22.5%減)となりました。

なお、当期時点で「4年累計経常利益率」は26.7%となり、当社の目指すべき目標の1つである「4年累計経常利益率20%以上」を3期連続で達成しました。

■財政状態

当期末の総資産は、前期末と比べ18億33百万円増加し、2,581億80百万円となりました。これは、売上高の減少に伴って売掛金が減少した一方、桑畑工場A棟Cゾーンの建設によって建物及び構築物が増加したことによるものです。負債は、前期末と比べ130億11百万円減少して380億71

百万円となりました。これは、主に未払法人税等が減少したことによるものです。

純資産は、前期末と比べ148億45百万円増加して2,201億9百万円となり、自己資本比率は前期末比5.1ポイント上昇し84.8%となりました。

■キャッシュ・フロー

営業活動では、273億11百万円の資金増加、投資活動では、145億13百万円の資金減少だったことからフリー・キャッシュ・フローは、127億98百万円の資金増加となりました。これは、投資活動において桑畑工場A棟Cゾーン建設などの有形固定資産の取得による資金支出があったものの、営業活動において税金等調整前当期純利益などの資金増加があったためです。財務活動では、主に配当金の支払いによって129億82百万円の資金減少となりました。

これらの結果、当期末の資金残高は前期末から1億94百万円減少し853億51百万円となりました。

2020年3月期第1四半期の連結業績予想

半導体・電子部品業界において顧客の投資意欲が短期間で激しく変動することから需要予測が困難なため、業績予想の開示方法については、「1四半期先までの開示」としております。

足元では引き続きメモリ向けを中心とした幅広い用途において需要は底堅く推移する見込みであります。

(金額の単位:百万円)

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
35,800	8,700	8,800	6,300	175.36



ディスコの企業理念



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評価されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができているか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。